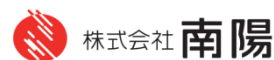


2026 年 9 月 16 日

各位



【出展のお知らせ】第 3 回[九州]半導体産業展

当社は「第 3 回[九州]半導体産業展」に出展いたします。

昨年に続き、更に充実した内容にて最新の製品や技術をご紹介しますので、この機会に是非、当社ブースにお立ち寄りください。



出典：第 3 回[九州]半導体産業展 HP <https://k-semi.jp/>

会 期 : 2026 年 9 月 30 日 (水) ~ 10 月 1 日 (木)

開 場 時 間 : 10 : 00 ~ 17 : 00

会 場 : マリンメッセ福岡 (B 館)

当社ブース : B8-18

問い合わせ先 : (株)南陽 産機事業本部 ASS 部 [TEL:092-473-7711](tel:092-473-7711)

【展示内容】

今回は「アドバンストパッケージングや PLP、TSV、TGV のウエハー工程向け検査・測長ソリューション (表面～内部～量産ラインまでの一気通貫エコシステム)」をテーマに、最新技術の X 線、IR、光学技術を駆使したソリューションをご紹介します。

1. TSV,TGV,トレンチ工程向け超高速「深さ」「厚み」測定機(ブースにて実演デモを予定)
1 μ m 径の微細穴構造に対応し、リアルタイム (30,000 点/秒) で「深さ」と「厚み」を高精度に同時評価できる測定機です。多層膜でも 5 0 μ m 以上の厚みであれば測定可能であり、従来の白色干渉方式では測定が困難であった「深さ」と「厚み」の同時測定をご体験ください。
2. インライン型 3D 基板外観検査装置「TI-GTI」
高精度 3D 計測技術を搭載したインライン AOI と予め学習済みの AI 不良分類を組み合わせた実装工程向けの最新外観検査ソリューションです。高度なはんだフィレット検査で品質向上と歩留まり改善を支援します。

3. 卓上型 3D DIP 外観検査装置「TI-V100d」(ブースにて実演デモを予定)

DIP 実装検査で死角をなくす 4 方向斜視撮像と高精度 3D 計測を組み込んだ DIP 特化の卓上型 AOI です。高度なはんだ検査と部品検査で品質向上に貢献します。

4. 先端パッケージ向け サブミクロン 2D/3DX 線検査装置「CA20」

高解像度撮像により、はんだバンプや TSV などの微細欠陥を高速かつ非破壊で検出可能です。AI による欠陥解析と全自動検査で品質向上と量産立上の迅速化を実現します。

5. 半導体・先端実装向け 高分解能 3D X 線 CT 検査装置「FF35FYNE」

新型ナノフォーカス X 線管を搭載し、業界最高クラスのハイエンド解析用 CT 検査装置です。Zoom スキャン等多彩な撮影技術で、高精細観察と高速検査を両立します。

【来場登録 URL】

<https://kyusyu.innovent-expo.jp/semi/entry/>

